

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议、券商策略会
参与单位名称及人员姓名	国海证券、华泰资管（10月30日） 中泰证券策略会（11月7日） 兴业证券、国信证券（11月11日） 中金公司策略会（11月14日） 华泰证券、人保资产（11月15日） 易方达基金（11月19日） 花旗银行（12月3日）
时间	2024年10月30日-2024年12月3日
地点	公司会议室、苏州、北京
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况 公司主营业务为 PCB 专用设备的研发、生产和销售，产品覆盖多层板、HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等所有细分 PCB 产品的压合、钻孔、曝光、成型、检测等关键工序，是全球 PCB 专用设备行业中产品线最广泛的企业之一；提供包括层压系统，机械钻孔、CO ₂ /UV/新型激光钻孔方案，LDI 激光直接成像方案，机械成型、激光成型方案，专用、通用、高精电测方案，自动光学检测及外观检查方案等多系列多种类的一站式 PCB 加工解

决方案；另外，业务拓展至机械钻孔和成型加工紧密相连的刀具领域，提供自主专利的 PVD 纳米涂层服务，降低下游客户钻孔及成型工序综合运营成本。

公司深耕 PCB 行业 20 余年，通过创新的业务发展模式，形成了技术、产品、应用场景、供应链、客户的多维协同，市场地位持续保持领先，屡次荣获行业知名上市企业“金牌供应商”、“优秀供应商”、“最佳设备合作伙伴”等荣誉奖项，与行业众多龙头客户形成良好的战略合作关系，成为客户端新场景、新项目研发的优先合作伙伴。

二、公司 2024 年前三季度业绩增长的原因

公司 2024 年前三季度营业收入大幅增长的原因，主要是得益于消费类电子市场回暖及新能源汽车电子技术升级，加上 AI 服务器在内的算力产业链需求强劲，拉动了下游客户的资本支出；同时，公司创新产品市场竞争力持续攀升，共同促进公司专用加工设备销售的显著增长。

三、公司在传统 PCB 市场的业务情况

在竞争最为激烈的多层板市场，客户降本增效需求持续。公司推出的第二代钻房自动化方案，加上高功率阻焊激光直接成像系统、自动上下料机械成型机、电测与自动外观检查一体机、自动分拣包装机等自动化、数字化、智能化的解决方案，可大幅降低下游客户的人力成本支出，提升客户端设备稼动率及产品品质，受到客户的高度认可。

公司将持续深挖多层板市场价值，加大创新研发力度，针对不同终端的个性化特点，打造超越客户预期的优化解决方案，并通过产业链上下游价值发现机制，不断拓宽公司产品矩阵，持续放大公司在该市场的价值。

四、高技术附加值 PCB 产品的发展趋势及公司布局的相关产品情况

长期来看，AI 算力产业链从数字基建到应用终端逐步发展，对高速通讯设备、高端 AI 服务器、大型数据中心等基础设施及 AI 手机、AI PC 的需求显著增加，AI 相关电子终端产品已成为 PCB 产业发展的新一轮推动要素，未来大尺寸封装基板、高多层板及 HDI 板等产品的需求增加将带动行业的持续投资，促进专用加工设

	<p>备市场的不断成长。</p> <p>在高多层板市场，针对 AI 服务器、高速交换机等终端采用更高层数、更高密度的高速多层板，公司推出的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机、高功率及能量实时监测的 CO₂ 激光钻孔机、高性能激光直接成像系统、大台面六倍密通用测试机及 CCD 四线测试机等系列产品，可充分满足服务器等大厚板高品质、高可靠性加工，确保高速 PCB 的信号完整性，助力下游客户快速开拓增长强劲的高多层板市场，提升公司在该市场的营收水平。</p> <p>在传统及任意层 HDI 市场，HDI 板的特征尺寸进一步微缩，公司持续升级四光束 CO₂ 激光钻孔机、高解析度激光直接成像系统及高精测试机等产品性能，以满足该市场不断提升的技术要求。另外，AI 智能手机及光模块越来越多采用类载板，带动了微小盲孔等高精度加工专用设备需求，公司提供新型激光加工方案，可满足微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工要求，为行业新兴应用提供新动力。</p> <p>针对大尺寸 FC-BGA 先进封装基板 ABF 增层数增加及特征尺寸变小等特点，公司创新运用新型激光加工技术，开发出用于先进封装基板多制程成套加工方案，相关设备及工艺方案已获得行业头部客户的认证及正式订单，未来公司高附加值 PCB 加工设备的销售占比将进一步提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 3 日